

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>5</sup> H01L 21/56	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1992-0005289 1992년 03월 28일
(21) 출원번호	특 1991-0013369	
(22) 출원일자	1991년 08월 02일	
(30) 우선권주장	90-205606 1990년 08월 02일 일본(JP)	
(71) 출원인	도레이 다우코닝 실리콘 가부시끼가이샤	
(72) 발명자	일본국 도오교도 슈오꾸 니혼바시무로마찌 2쵸메 3반 16고 나카요시 가즈미 일본국 지바켄 이찌하라시 유수다이 니시 1쵸메 6반지 미네 가쓰토시 일본국 지바켄 이찌하라시 아오바다이 7쵸메 20반지 2	
(74) 대리인	이병호, 최달용	

심사청구 : 없음

(54) 플립 칩 반도체 장치

요약

내용 없음

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

플립 칩 반도체 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 플립 칩(LSI 칩)반도체 장치의 한 실시예의 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

활성 표면과 상기 활성 표면에 위치하는 다수의 전기 단자 패드를 구비하는 플립칩형 반도체 소자와, 상기 반도체 소자의 단자 패드에 대응하는 다수의 전기 단자 패드를 포함하고 있는 베이스 플레이트를 구비하는 반도체 장치로서, 상기 반도체 소자의 전기 단자 패드는 25℃에서 100kgf/cm<sup>2</sup> 정도의 장력 Young의 계수값을 나타내는 도전성 실리콘 탄성 중합체에 의해 상기 베이스 플레이트상의 대응단자 패드에 연결되며, 상기 활성 표면은 상기 활성 표면과 상기 베이스 플레이트간의 공간을 점유하는 전기적 절연 탄성중합체 밀봉재로 코팅되는 반도체 장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 전기적 절연 탄성 중합 밀봉재가 실리콘 밀봉제인 반도체 장치.

청구항 3

제2항에 있어서, 도전성 실리콘 탄성중합체 및 전기 절연성 탄성중합적인 밀봉재가 하이드로실릴레이션 반도체 장치.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 전기 도전성 실리콘 탄성 중합체는 도전성 충전재로서 미세하게 분쇄된 은을 포함하는 반도체 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임

도면

도면1

